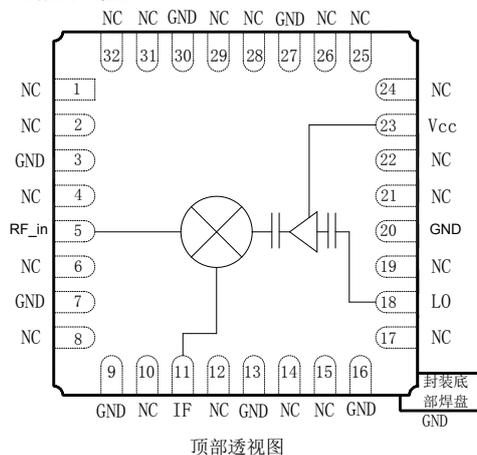


特点:

- 变频损耗: 10dB
- 输入 P₋₁: 10dBm
- 本振功率: 0dBm
- SMT 封装
- 封装尺寸: 5.0×5.0×1.2mm
- 工作温度: -55℃~+85℃
- 产品执行标准为 GJB8481-2015

性能参数: (T_A= -55~+85℃)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
射频频率	f _{RF}	f _{RF} = 0.9~2.9 GHz f _{LO} = 0.9~2.9 GHz V _{CC} = +5V LO: 0dBm	0.9		2.9	GHz	
本振频率	f _{LO}		0.9		2.9	GHz	
中频频率	f _{IF}		0.01		0.8	GHz	
变频损耗	IL			9	13	dB	
隔离度 (LO to RF)	ISO _{LO to RF}			26	30	dB	
隔离度 (LO to IF)	ISO _{LO to IF}			16	25	dB	
隔离度 (RF to IF)	ISO _{RF to IF}			6	15	dB	
输入 P ₋₁	P ₋₁			9	13	dBm	
电源电流	I _{CC}	V _{CC} = +5V		50	60	mA	
重量	m				1	g	

功能框图:

极限参数表:

参数名称	极限值
电源电压	+6V
射频最大输入功率	18dBm
本振最大输入功率	10 dBm
沟道温度	150℃
工艺应用温度	260℃, 20s
工作温度	-55~+85℃
贮存温度	-55~+125℃
静电防护等级(HBM)	Class 1A

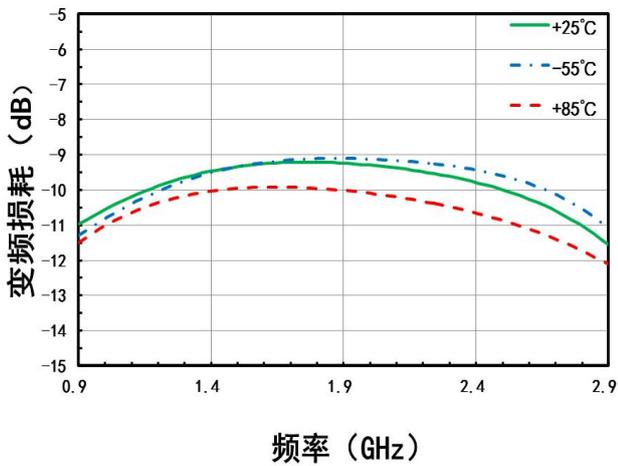
超过以上条件, 可能引起器件永久损坏。

引脚定义:

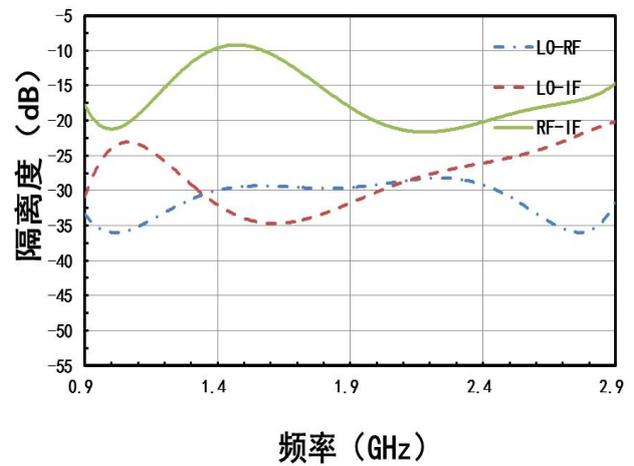
引脚编号	符号	描述
5	RF	射频端口
11	IF	中频端口
18	LO	本振端口
23	V _{CC}	电源端口 (+5V)
3/7/9/13/16/20/27/30/底部	GND	接地端
其他	NC	悬空



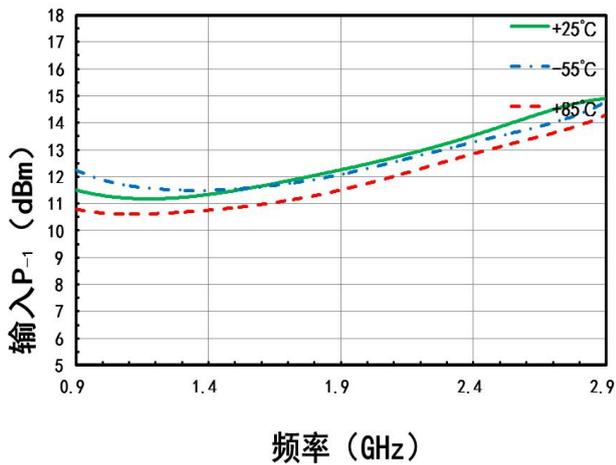
IF=800MHz变频损耗VS. 温度



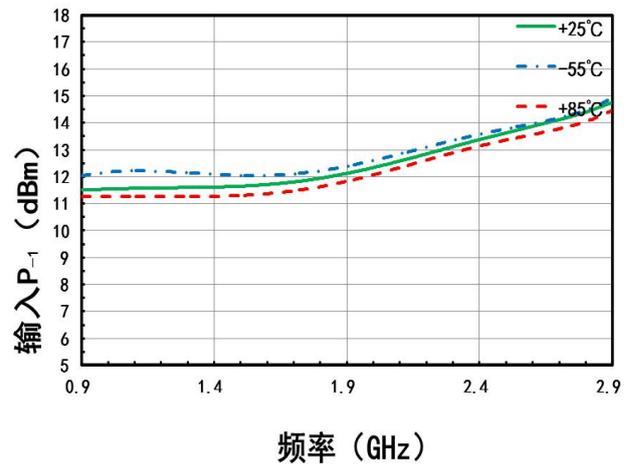
隔离度



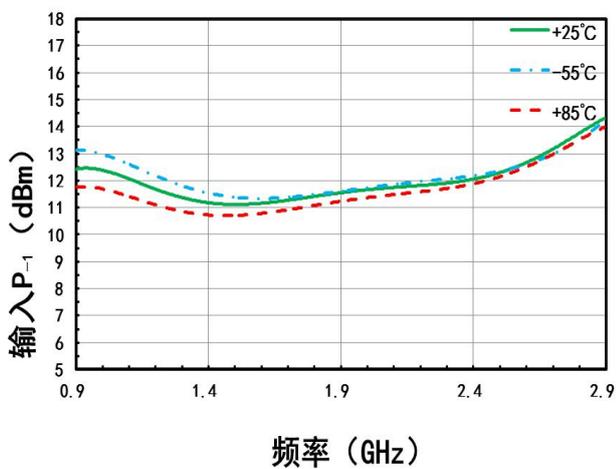
IF=45MHz输入P₋₁VS. 温度



IF=180MHz输入P₋₁VS. 温度

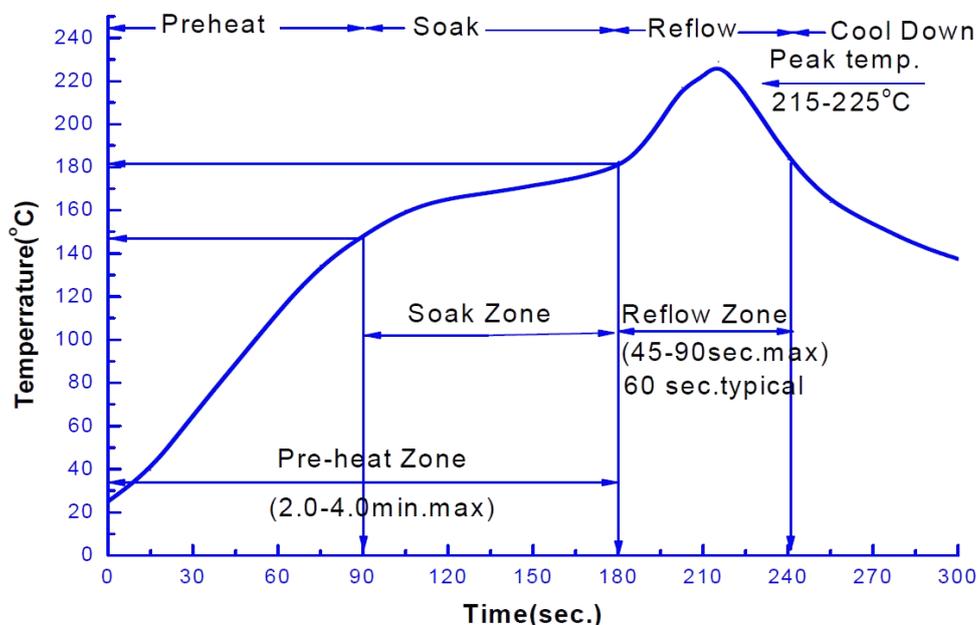


IF=800MHz输入P₋₁VS. 温度



产品使用注意事项：

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃ 回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

4. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品禁止采用超声波清洗，避免内部元器件及焊点受力影响可靠性。
6. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
7. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。